

Lenovoがお勧めするWindows 8.

主なスペック ※組み合わせによりスペックが選択できないものがあります。詳しくはWebサイトをご確認ください。

	ThinkStation E32 SFF	ThinkStation E32	ThinkStation S30	ThinkStation C30	ThinkStation D30
タイプ	省スペース	エントリー	スタンダード	コンパクトハイエンド	ハイエンド
OS	Windows 8 Pro (64bit) / Windows 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit 正規版				
その他の稼働確認OS	Windows 8 (64bit) / Windows 8 Pro (64bit) / Windows 7 Ultimate with Service Pack 1 (SP1) 64bit 正規版 / Windows 7 Ultimate with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版 / Windows 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit 正規版 / Windows 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版 / Windows 7 Home Premium with Service Pack 1 (SP1) 64bit 正規版 / Windows 7 Home Premium with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版 / Windows 7 Home Basic with Service Pack 1 (SP1) 64bit 正規版 / Windows 7 Home Basic with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版 / Red Hat® Enterprise Linux® 6.2 / PC DOS		Windows 8 (64bit) / Windows 8 Pro (64bit) / Windows 7 Ultimate with Service Pack 1 (SP1) 64bit 正規版 / Windows 7 Ultimate with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版 / Windows 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit 正規版 / Windows 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版 / Windows 7 Home Premium with Service Pack 1 (SP1) 64bit 正規版 / Windows 7 Home Premium with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版 / Windows 7 Home Basic with Service Pack 1 (SP1) 64bit 正規版 / Windows 7 Home Basic with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版 / Windows XP Professional with Service Pack 3 (SP3) 64bit 正規版 / Windows XP Professional with Service Pack 3 (SP3) 32bit 正規版 / Red Hat® Enterprise Linux® 6.2 / PC DOS		
CPU	インテル® Xeon® プロセッサー E3-1200 v3ファミリ / インテル® Core™ i3 / i5 / i7 プロセッサー		インテル® Xeon® プロセッサー E5-2600 / 1600ファミリ	インテル® Xeon® プロセッサー E5-2600ファミリ	
最大TDP ^{※1}	95W		135W	150W	
プロセッサー搭載可能数	1		2		
最大メモリ容量	32GB		128GB ^{※2}	256GB ^{※2}	
メモリスロット数	4		8	16	
最大グラフィックカード・サポート	1×NVIDIA® Quadro® K600	1×NVIDIA® Quadro® K2000	1×NVIDIA® Quadro® 6000 または 2×NVIDIA® Quadro® K5000		
接続可能モニター数 ^{※3}	4		8		
HDD最大搭載本数	2 (SATA / SSD) ^{※4}	2 (SATA / SSD)	3 (SAS / SATA / SSD)		5 (SAS / SATA / SSD)
RAID	—	RAID 0,1	RAID 0,1,5		RAID 0,1,5,10
電源容量	240W	280W	610W	800W	1120W
本体寸法 (キャリア・ハンドル含む) (幅×奥行×高さ) mm	102×375×338	175×431×425	175×460×478	130×444×427	210×602×490

※1:TDP=Thermal Design Power (熱設計電力)の略 ※2:2CPU搭載可能モデルにおいては、1CPU搭載時は使用可能なメモリスロットが制限され、最大メモリ容量は各表記の半分の容量となります。 ※3:一部のモニター接続台数につきましては、通常のカテゴリモデルで対応しない場合がございます。詳細はレノバにご確認ください。 ※4:SFFモデルでのHDD 2本搭載は出荷時構成でのみ対応可能です。

ThinkStationの安心の保証内容

このカタログに掲載されているThinkStationをご利用の皆さまに対して、万一の故障やトラブルにも万全に対応する安心の保証を標準でご提供します。

※詳細は製品に同梱されている「保証期間・保証窓口のご案内」をご参照下さい。

■ 翌営業日対応オンサイト修理サービス*

お客様の機器設置場所までオンサイト (出張) 修理に伺います。

※ 日本国内限定

■ パーツ送付サービス (CRU)*

迅速な障害復旧のための交換可能部品 (HDD、キーボード、マウスなど) の送付。

※ 日本国内限定

■ IWS (International Warranty Service)

IWS (International Warranty Service: 国際保証サービス) は、保証期間内であればLenovo製品を購入了れた国だけでなく、他の国でも無償で保証サービスが受けられるものです。ただしハードウェアのみが対象です。

※ 持ち込む国のLenovoの保証条件が適用されますので、日本と同一とは限りません。

● ご購入時に適用されている上記保証内容は、ご希望にて有償で延長することもできます。詳しいサービス内容については、上記サイトで確認するか、PCサービスお申し込み窓口 (0120-559-592) へお問い合わせください。

ThinkPlus Services <http://www.lenovo.com/jp/pc/thinkplus/>

ThinkPlusはThinkStationをご購入のお客様に、保証/保守サービスのサービス・レベルとサービス期間をアップグレードするものです。

■ 窓口

■ PCサポート 最新のテクニカル情報をおオンラインにてご提供。

ハードディスク上のデータ消去に関するご注意

お客様 (パソコン・ユーザー様) が、廃棄・譲渡等を行う際に、ハードディスク上の重要なデータが流出するというトラブルを回避するためには、ハードディスクに記録された全データを、ユーザー様の責任において消去することが非常に重要となります。一般的なデータ消去作業 (ゴミ箱を空にする) コマンドの利用、ディスクのフォーマット、リカバリCDでの初期化等) では、悪意のある人により、重要なデータを読み取られ、予期しない用途に利用される恐れがあります。Lenovoでは専用のソフトウェアあるいはサービス (共に有償) をご利用いただくか、ハードディスクそのものを物理的・磁気的に破壊して、データを読めなくすることを推奨します。

Lenovoが推進する環境基準

詳しくは<http://www.lenovo.com/jp/>より、リソースカテゴリの「環境・リサイクル」をご覧ください。



環境マネジメント基準
「EPEAT」ゴールド



有害物質規制
「RoHS指令」



省エネ法に基づく
エネルギー消費効率
(省エネ法の対応)



インテル® Xeon® プロセッサー
E3 ファミリー搭載

*1 HT テクノロジーを利用するには、HT テクノロジーに対応したプロセッサーを搭載したコンピュータシステム、および同技術に対応したチップセットとBIOS、OS が必要で、性能は、使用するハードウェアやソフトウェアによって異なります。インテル® Core™ i5-750 デスクトッププロセッサーはHT テクノロジーをサポートしていません。HT テクノロジーに対応したプロセッサーの情報は、<http://www.intel.com/technology/platform-technology/hyper-threading/> (英語) を参照してください。
*2 インテル® Xeon® プロセッサーは、インテル® Xeon® プロセッサー E3000 シリーズでは、256GBのインテル® Xeon® プロセッサー E5000 シリーズでは、512GBのインテル® Xeon® プロセッサー E5000 シリーズで、一部のインテル® Xeon® プロセッサー E5000 シリーズでは、最大 256GB のメモリをサポートします。各 PC メーカーにお問い合わせください。実際の性能はハードウェア、ソフトウェア、システム構成によって異なります。詳細については、<http://www.intel.com/jp/technology/turboboost/> を参照してください。
*3 インテル® AMT に対応したチップセット、ネットワークハードウェア、ソフトウェアを併用し、インテル® AMT の機能が有効にされたシステムが、企業 LAN に接続されている必要があります。ノートブック PC の場合、ネット OS ベースの VPN 上や、ワイヤレス接続時、バッテリー駆動時、スリープ状態、ハイバネーション時、電源の節約時には、インテル® AMT を利用できないことや、一部の機能が制限される場合があります。実際の結果はハードウェア、ソフトウェア、構成によって異なります。詳細については、<http://www.intel.com/jp/technology/platform-technology/intel-amt/> を参照してください。

Lenovo、Lenovo、Lenovo、ThinkCentre、ThinkPad、ThinkStation、ThinkServer、New World New Thinking、ThinkVantage、ThinkVantage、ThinkVantage、ThinkVantage、Rescue and Recovery、UltraNav は、Lenovo Corporation の商標。 Microsoft、Windows、Windows ロゴ、Windows Vista start button、Windows Aero、Windows BitLocker、Windows HotStart、Windows Live、Windows Media、Windows ReadyBoost、Windows ReadyDrive、Windows Server、Windows SideShow、Windows SuperFetch、Windows Vista、DirectX、Internet Explorer、Xbox 360、Excel、InfoPath、OneNote、Outlook、PowerPoint、Visio、Office ロゴ、Intel Mouse は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Centrino、Centrino Inside、Centrino ロゴ、Intel Viv、Intel Viv ロゴ、Intel vPro、Intel vPro ロゴ、Celeron、Celeron Inside、Intel Core、Core Inside、Itanium、Itanium Inside、Pentium、Pentium Inside、Viv Inside、vPro Inside、Xeon、Xeon Inside は、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporation の商標です。他の会社名、製品名、サービス名等は、それぞれ各社の商標または登録商標。

● このカタログで使用されている製品の写真は、出荷時のものと一部異なる場合があります。また、仕様は事前の予告なしに変更する場合があります。● 表示画面および印刷物の出力例のうち、特に断り書きのない出力例のデータ部分はすべて架空のもので、● 画面ははめ込み合成で実際の表示とは異なります。● このカタログの情報は2013年5月現在のものです。● 製品、サービス等詳細については、弊社もしくはビジネス・パートナーの営業担当員にご相談ください。● このカタログに掲載されている標準価格および料金は、2013年9月現在のものです。事前の予告なしに変更する場合があります。最新の価格に関しては、弊社ホームページをご参照ください。● 「ダイレクト価格」は、直販による提供価格であり、ビジネス・パートナーなど再販者の販売価格を拘束するものではありません。弊社ホームページでは供給状況などの事情により一部の製品を掲載しており、「ダイレクト価格」製品すべてが弊社ホームページで購入できることを意味するものではありません。● 当カタログ記載の製品にプリインストールあるいは添付されているソフトウェア製品につきましては、その梱包方法および内容物に関し、市販されているものとは異なる場合があります。



レノボ・ジャパン株式会社 〒106-6118 東京都港区六本木6-10-1 六本木ヒルズ森タワー18階

13-05 Printed in Japan

Lenovoがお勧めするWindows 8.



THINKSTATION D30

ハイエンド・ワークステーション

THINKSTATION C30

コンパクトハイエンド・ワークステーション

THINKSTATION S30

スタンダード・ワークステーション

THINKSTATION E32

エントリー・ワークステーション

THINKSTATION E32 SFF

省スペース・ワークステーション

ワークステーション総合カタログ

インテル® Xeon® プロセッサー E5 / E3ファミリー搭載。さらなるパフォーマンスでビジネスの創造力を加速する、レノボ ThinkStation シリーズ。



THINKSTATION E32 SFF

THINKSTATION E32

THINKVISION LT3053p Wide

モニター別売

当カタログの最新情報は下記をご覧ください www.lenovo.com/jp/pc/bs 当カタログ発行後に修正や変更があった場合など情報をタイムリーに提供するホームページです。定期的にWebをチェックして、PCの最新の情報を手に入れてください。

製品についてのご相談、ご購入 受付時間 / 9:00-18:00 (土、日、祝日、5/1、12/30-1/3を除く)

中規模企業・大規模企業 (従業員1,000人以上) および企業グループのお客様 / 公共機関のお客様

個人事業主・SOHO・中小規模企業 (従業員数1,000人以下) のお客様

個人のお客様

☎ 0120-804-982

☎ 0120-977-576

☎ 0120-804-545

ビジネス・パートナー様向け ☎ 0120-977-576 受付時間 / 9:00-12:00、13:00-18:00 (土、日、祝日、5/1、12/30-1/3を除く)

インテル® Xeon® プロセッサー E3 ファミリー搭載



THINKSTATION

高性能ワークステーション

インテル® Xeon® プロセッサー E5/E3ファミリー搭載。 ビジネスの高度化に対応するワークステーションシリーズ。

ワークステーションに求められるもの。それはビジネスを効率化する、高い信頼性と強力な処理能力です。レノボThinkStationシリーズは、新世代プロセッサーを搭載し、余裕のパフォーマンスを獲得。あわせてシステム全体の最適化を進めることで、より一層の高性能を実現。生産性の向上と高い作業効率で、プロフェッショナルユーザーの能力を自在に発揮できる環境を提供します。



PERFORMANCE

高性能プロセッサーで高いパフォーマンスを発揮

ハイエンド・ミッドレンジクラスのプロセッサーには、32nmプロセスで製造された、インテル® Xeon® プロセッサーE5シリーズを搭載。エントリークラスには、22nmプロセスで製造されたインテル® Xeon® プロセッサーE3-1200 v3やインテル® Core™ プロセッサー・ファミリーを搭載しています。高度な演算能力を必要とするグラフィック処理や解析作業にも余裕のパフォーマンスを発揮。作業時間の短縮と高い生産性を実現します。

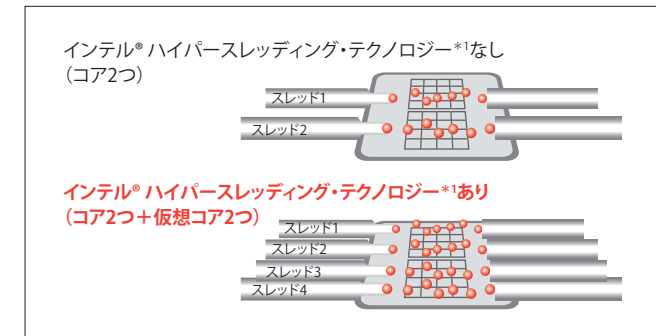


豊かな拡張性と高いパフォーマンス

レノボThinkStationシリーズは、高い処理能力に加えて用途に応じた豊かな拡張性を確保しています。上位機種ではデュアルCPUの搭載や、描画性能を高める高機能グラフィックスの追加に対応。各種シミュレーションや解析業務などの高負荷演算業務を効率化するGPUコンピューティングへの機能拡張も可能です。新たに登場した省スペースモデルも加わった充実のラインアップからお選びいただけます。

CPUを効率的に使い高速処理を実現

インテル® Xeon® プロセッサーは、スレッド化されたアプリケーションやマルチタスク時の演算を高速化する、インテル® ハイパースレディング・テクノロジーに対応。各コアの処理能力に応じて、1つのコアで2つのスレッドを並行処理。マルチコアCPUの処理能力を無駄なく使用することで、ハイパフォーマンスを発揮します。



消費電力の最適化を実現する先進技術採用

インテル® Xeon® プロセッサー・ファミリーには、インテル® インテリジェント・パワー・テクノロジーを採用。プロセッサー自体が各コアの作動状況や負荷に応じた発熱を監視。稼働状況に応じて、最適なパフォーマンスを実現しながらも消費電力をコントロールする省エネルギーテクノロジーです。

最大256GB、1600MHzのRDIMMを搭載可能

メモリーコントローラーをCPUに内蔵するインテル® クイックパスインターコネクトに対応し、メモリーの搭載は、最大256GBの1600MHz RDIMMを搭載可能*。ダイレクトにCPUに接続すると同時に帯域幅を拡大しているため、レイテンシーの大幅な削減と高速データ転送を実現し、快適な作業性を実現します。*Windows® 7環境では192GBに制限されます。

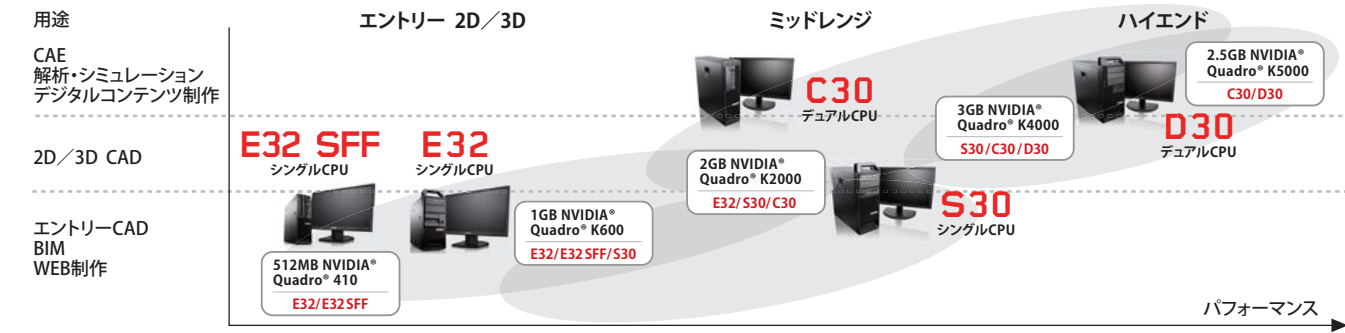
最新チップセットでシステム性能を大幅に向上

新世代CPUに合わせて新開発されたインテル® C602チップセットを採用。周辺機器や拡張性を大きく向上させています。新たに、SAS/SATAサポートに加え最大5基のストレージの装備を可能とし、従来の10倍の速度を実現するUSB3.0にも対応。さらに最新のグラフィックカードにも余裕で対応する帯域幅を確保したPCIe gen3も採用。高いパフォーマンスを必要とするワークステーションに求められる、最先端の機能と拡張性を装備しています。



最適なパフォーマンスが選べる充実のラインアップ

レノボ ThinkStationシリーズは、ビジネスに必要なパフォーマンスを自在に選べる豊富なラインアップ構成をご用意しています。クリエイターやエンジニアなど、ユーザーの業務とニーズに応じて、最適なパフォーマンスと機能拡張性をお選びいただけます。

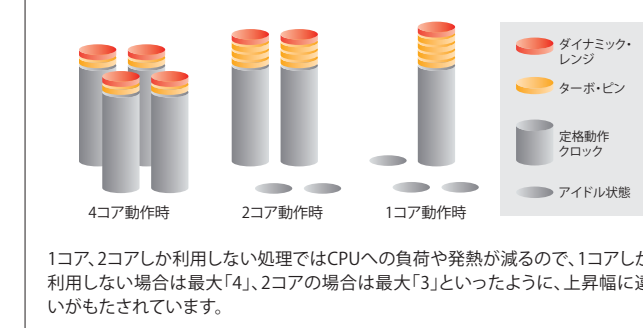


*上図のメモリ容量は各グラフィックカードの持つトータルフレームバッファの容量です。また、ThinkStationの機種とグラフィックカードの組合せは参考例です。

高負荷時は周波数を高めて高速処理

起動時や高負荷が掛かると、各コアの定格周波数を超えて高速処理する、インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0に対応。各コアの作動状況や内部の発熱、電力を詳細に監視し、負荷に応じて常に最適な処理能力を提供。高負荷時には必要に応じたパフォーマンスで高速処理を実現します。

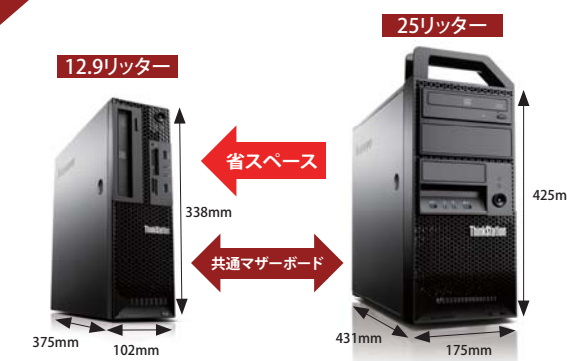
インテル® ターボ・ブースト・テクノロジー 2.0*2の動作イメージ



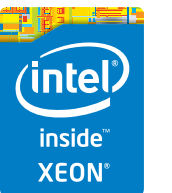
THINKSTATION E32 SFF

高い機能性を備えたSFFモデル

エントリークラスに、省スペース設計のThinkStation E32 SFFと、豊かな拡張性を備えたThinkStation E32の2つのモデルをラインアップ。省スペースモデルのE32 SFFは、わずか12.9リッターのコンパクトな筐体ながら、NVIDIA® Quadro® K600グラフィックスの搭載が可能です。またE32モデルは、25リッターの筐体でNVIDIA® Quadro® K2000までの搭載に対応しました。どちらも、フルスペックのC226チップセットと22nmプロセスで製造された最新プロセッサーを搭載。高いパフォーマンスを優れた初期コストで導入可能なバリューモデルです。



インテル® Xeon® プロセッサー E3ファミリー搭載



THINKSTATION E32/E32 SFF

エントリー・ワークステーション / 省スペース・ワークステーション

インテル® Xeon® プロセッサ E3-1200ファミリー搭載。
2つのサイズが選べるバリュー・ワークステーション



THINKSTATION E32 SFF

12.9リッターサイズの省スペースモデル

日本市場のニーズにあわせた、わずか12.9リッターのサイズにE32と同一のマザーボードを組み込み、設置場所を問わないPCと同等のコンパクトな筐体で、ワークステーションとしての信頼性とグラフィックス処理能力を実現したモデルです。

2D CAD	エントリー 3D CAD	BIM	WEB制作 DTP	医療
--------	-----------------	-----	--------------	----

稼働確認OS	Windows 8 (64bit) / Windows 8 Pro (64bit) / Windows 7 Ultimate with Service Pack 1 (SP1) 64bit 正規版 / Windows 7 Ultimate with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版 / Windows 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit 正規版 / Windows 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版 / Windows 7 Home Premium with Service Pack 1 (SP1) 64bit 正規版 / Windows 7 Home Premium with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版 / Windows 7 Home Basic with Service Pack 1 (SP1) 64bit 正規版 / Windows 7 Home Basic with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版 / Red Hat® Enterprise Linux® 6.2 / PC DOS
CPU	インテル® Xeon® プロセッサ E3-1200 v3ファミリー / インテル® Core™ i3/i5/i7 プロセッサ
メモリ	最大32GB (4メモリスロット)
HDD	HDD最大搭載本数: 2*
グラフィックスボード	NVIDIA® Quadro®
備考	DVDスーパーマルチドライブ / DVD-ROMドライブ

*SFFモデルでのHDD 2本搭載は出荷時構成でのみ対応可能です。



優れたパフォーマンスを実現

E32シリーズには、新世代のインテル® Xeon® プロセッサ E3-1200 v3や第4世代インテル® Core™ プロセッサファミリーを搭載。CPUにメモリー・コントローラーを統合し、1600MHzのDDR3高速メモリーを最大32GBまで実装可能です。5Gbpsの高速データ転送が可能なUSB3.0や6GbpsのSATA3.0にも対応。複雑な計算や高度なグラフィック処理もスムーズに行えます。



十分な拡張性を確保した筐体

ワークステーションとして高い拡張性を備えているのも、このモデルの特長です。ストレージは最大2基*まで、マルチモニターや3D対応のグラフィックスカードに対応します。(E32 SFFはロープロファイルのNVIDIA® Quadro® K600、E32 TowerはNVIDIA® Quadro® K2000まで搭載可能)。デジタルコンテンツの制作や設計業務など、高い画像処理能力を必要とする業務も快適に行えます。

余裕のある熱設計と高い静音性

ワークステーションならではの高性能を発揮するために、流体工学を駆使して設計されたエアフローと高度な排熱設計を実施。CPUや各種ドライブの熱を素早く排出し、高負荷時でも安定した性能を発揮します。同時に優れた静音性を実現し、アイドル時でわずか24dbと人のささやきよりも静かな作動音を実現し、快適な業務環境も実現しています。

使いやすさを追求したデザイン

最大5Gbpsの高速データ転送に対応したUSB3.0を筐体正面に配置。アクセスしやすい設計で、オプション等の着脱が容易に行えます。



インテル® Xeon® プロセッサ E3 ファミリー搭載



THINKSTATION S30

スタンダード・ワークステーション

インテル® Xeon® プロセッサ E5-2600 / 1600ファミリー搭載。
高度な業務に最適なスタンダード・ワークステーション



3D CAD	2D CAD	デジタル コンテンツ 制作	CAE	CAM
--------	--------	---------------------	-----	-----

稼働確認OS	Windows 8 (64bit) / Windows 8 Pro (64bit) / Windows 7 Ultimate with Service Pack 1 (SP1) 64bit 正規版 / Windows 7 Ultimate with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版 / Windows 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit 正規版 / Windows 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版 / Windows 7 Home Premium with Service Pack 1 (SP1) 64bit 正規版 / Windows 7 Home Premium with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版 / Windows 7 Home Basic with Service Pack 1 (SP1) 64bit 正規版 / Windows 7 Home Basic with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版 / Windows XP Professional with Service Pack 3 (SP3) 64bit 正規版 / Windows XP Professional with Service Pack 3 (SP3) 32bit 正規版 / Red Hat® Enterprise Linux® 6.2 / PC DOS
CPU	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2600 / 1600ファミリー
メモリ	最大128GB (8メモリスロット)
HDD	HDD最大搭載本数: 3
グラフィックスボード	NVIDIA® Quadro® (デュアルグラフィックカード対応)
備考	DVDスーパーマルチドライブ / DVD-ROMドライブ

*2CPU搭載可能モデルにおいては、1CPU搭載時は使用可能なメモリスロットが制限され、最大メモリ容量は各表記の半分の容量となります。



Lenovoがお勧めするWindows 8.

インテル® Xeon® プロセッサ搭載モデル

インテル® Xeon® プロセッサ E5-2600ファミリーと1600ファミリーに対応するスタンダードモデル。先進のアーキテクチャーで製造されたマルチコア・プロセッサは、コストパフォーマンスに優れ、3Dデジタルコンテンツの制作や3D CAD業務に強力なパワーを発揮します。最大128GBのメモリーを実装可能で、複数のタスクを効率的にこなすインテル® ハイパースレディング・テクノロジーにも対応。USB3.0やPCIe gen3にも対応し、業務に合わせた最適な構成を実現します。



余裕のある機能拡張性

S30は、余裕のある拡張性を備え、業務に必要な機能を自在に構成可能です。HDDは最大3基まで設置可能で、高速起動に効果的なSSDも最大256GBまで搭載可能。重要なデータ保護に効果的の高いRAID構成にも対応します。マルチモニター環境に対応するグラフィックカードの装着も可能です。



ハイエンドGPUにも対応

最先端のグラフィックスソリューションQuadro®に対応。グラフィックカードの増設により、高性能な演算機能やグラフィック機能を大幅にアップすることも可能です。最新のGPUコンピューティングに対応するNVIDIA® Tesla™の実装も可能。高性能な描画と処理能力を実現し、高度な業務にも余裕で対応する作業環境が得られます。

ワークステーションならではの信頼性

ThinkStation S30は、設計業務や3Dデジタルコンテンツの作成など、インテル® Xeon® プロセッサファミリーの強力な処理能力に加え、信頼性の高いパーツを選択。さらに、過酷な業務使用を想定し、安定した稼働を実現する熱設計や高耐久性を考慮した設計を施し、ワークステーションならではの高い信頼性をお届けします。



インテル® Xeon® プロセッサ E5 ファミリー搭載



THINKSTATION C30

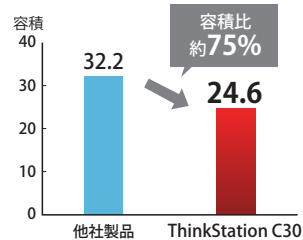
コンパクトハイエンド・ワークステーション

インテル® Xeon® プロセッサ E5-2600ファミリー搭載。
クラス最小筐体のデュアルCPU対応コンパクトハイエンド・ワークステーション



最大8コアCPUをデュアルで搭載可能

わずか容積24ℓのサイズでありながら、デュアルCPUを搭載可能にしたコンパクトワークハイエンド・ステーション。幅130×高さ427×奥行き444mmの筐体に高性能ワークステーションの機能を凝縮し、優れたスペース効率と処理能力を両立。最新の8コア16スレッドCPU×2基搭載可能で、高度な業務にも余裕を持って対応できます。メモリーは1600MHzのRDIMMに対応し、最大128GB搭載可能、大容量データもスムーズに処理します。SASコントローラーも搭載可能。限られたスペースで高性能を発揮するハイパフォーマンスモデルです。



高度な業務も余裕でこなせる高性能モデル

インテル® Xeon® プロセッサ E5-2600ファミリーのCPUを採用。CPUには最大20GBのキャッシュを搭載しています。負荷の掛かる処理を高速化する、インテル® ターボ・ブースト・テクノロジーやインテル® ハイバースレディング・テクノロジーにも対応し、高負荷の掛かる業務にも快適なパフォーマンスを発揮。メモリーコントローラーを内蔵したCPUにダイレクトに搭載されるメモリーと最大20MBの大容量キャッシュの採用で、大量のデータ処理や複雑な演算にも余裕を持って対応することが可能です。

GPUコンピューティングにも対応

BIMによる建築ビジュアライゼーションや、3D CADやリッチな3Dデジタルコンテンツの作成、大量のデータ処理を行う金融トレーディングなど、ワークステーションならではの高性能を必要とするユーザーには、NVIDIA® Tesla™ を使ったGPUコンピューティングや、Tesla™ +Quadro® を搭載するMaximus™ テクノロジーへの対応も可能。レンダリングやCAEなどの、マシンに高い負荷の掛かる作業にも快適な環境が得られます。

ラックマウントも可能な筐体

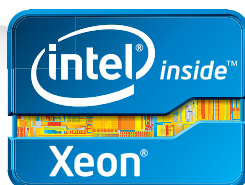
C30のコンパクトな筐体は、デスクサイドへの設置も簡単。3Uサイズなので、スペース効率に優れたラックマウントとして稼働させることも可能です。42Uのラックなら最大14台のC30を設置可能。集中管理によるメンテナンス性の向上や運用管理コストを削減することも可能です。



※写真は実物と異なる場合がございます。



インテル® Xeon® プロセッサ E5ファミリー搭載



THINKSTATION D30

ハイエンド・ワークステーション

インテル® Xeon® プロセッサ E5-2600ファミリー搭載。
8コア2CPUに対応するハイエンド・ワークステーション



圧倒的なパフォーマンスを実現する高性能モデル

レノボ ThinkStationシリーズのトップレンジモデル D30は、インテル® Xeon® プロセッサ E5-2600ファミリーを最大2基、最大256GBのメモリーを搭載可能です。クラス最高の最大5基のストレージスペースを確保。充実した拡張性とダウンタイムの最小化を実現する高い信頼性を備えたモデルです。高い負荷の掛かるCAEや3D CAD、各種の解析作業や動体シミュレーションなど、高度な演算能力と描画性能を必要とするあらゆる業務に、ストレスの少ない快適な作業環境を提供します。



高性能CPUで高度な演算能力を発揮

ThinkStation D30は、最大8コア×2基のCPUの搭載が可能です。処理能力を高めるインテル® ターボ・ブースト・テクノロジーやインテル® ハイバースレディング・テクノロジーにも対応し、高負荷の掛かる業務にも快適なパフォーマンスを発揮。メモリーコントローラーを内蔵したCPUにダイレクトに搭載されるメモリーと最大20MBの大容量キャッシュの採用で、大量のデータ処理や複雑な演算にも余裕を持って対応することが可能です。

豊富な拡張性で最先端の機能を利用可能

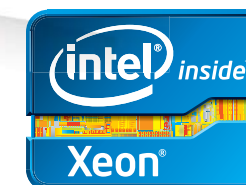
プロフェッショナルな業務に最適なパフォーマンスを実現するために、D30には充実した拡張性を確保しています。データの安全性を高めるストレージはクラス最大の5基。信頼性の高いSASストレージやレスポンスに優れたSSDにも対応可能です。描画機能を高める高性能グラフィックカードのデュアル搭載にも対応し、NVIDIA®のTesla™ を利用した最先端のGPUコンピューティングも利用可能な構成としています。

ユーザビリティの向上と冗長性の確保

D30には、ダウンタイムを最小化するためにレノボ独自の設計が施されています。熱に弱いCPUやHDD、拡張カードの各パーツを、それぞれ効率的に冷却するエアフロー構造とし、部品への熱による影響を排除。システムが各部品の振動の影響を受けないように、各所に防振ゴムを採用しました。さらにスピーディーな内部アクセスを可能にするツールレス設計など、システムの安定性と、作業時の静音性を確保するために配慮されています。



インテル® Xeon® プロセッサ E5ファミリー搭載



グラフィックデザイン	3D CAD	BIM	デジタルコンテンツ制作	金融トレーディング
------------	--------	-----	-------------	-----------

稼働確認OS	Windows 8 (64bit) / Windows 8 Pro (64bit) / Windows® 7 Ultimate with Service Pack 1 (SP1) 64bit 正規版 / Windows® 7 Ultimate with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版 / Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit 正規版 / Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版 / Windows® 7 Home Premium with Service Pack 1 (SP1) 64bit 正規版 / Windows® 7 Home Premium with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版 / Windows® 7 Home Basic with Service Pack 1 (SP1) 64bit 正規版 / Windows® 7 Home Basic with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版 / Windows® XP Professional with Service Pack 3 (SP3) 64bit 正規版 / Windows® XP Professional with Service Pack 3 (SP3) 32bit 正規版 / Red Hat® Enterprise Linux® 6.2 / PC DOS
CPU	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2600ファミリー
メモリー	最大128GB (8メモリスロット)*
HDD	HDD最大搭載本数:3
グラフィックスボード	NVIDIA® Quadro® (デュアルグラフィックカード対応)
備考	DVDスーパーマルチドライブ / DVD-ROMドライブ

※2CPU搭載可能モデルにおいては、1CPU搭載時は使用可能なメモリスロットが制限され、最大メモリー容量は各表記の半分の容量となります。



グラフィックデザイン	解析・シミュレーション	3D CAD	CAE	EDA
------------	-------------	--------	-----	-----

稼働確認OS	Windows 8 (64bit) / Windows 8 Pro (64bit) / Windows® 7 Ultimate with Service Pack 1 (SP1) 64bit 正規版 / Windows® 7 Ultimate with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版 / Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 64bit 正規版 / Windows® 7 Professional with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版 / Windows® 7 Home Premium with Service Pack 1 (SP1) 64bit 正規版 / Windows® 7 Home Premium with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版 / Windows® 7 Home Basic with Service Pack 1 (SP1) 64bit 正規版 / Windows® 7 Home Basic with Service Pack 1 (SP1) 32bit 正規版 / Windows® XP Professional with Service Pack 3 (SP3) 64bit 正規版 / Windows® XP Professional with Service Pack 3 (SP3) 32bit 正規版 / Red Hat® Enterprise Linux® 6.2 / PC DOS
CPU	インテル® Xeon® プロセッサ E5-2600ファミリー
メモリー	最大256GB (16メモリスロット)*
HDD	HDD最大搭載本数:5
グラフィックスボード	NVIDIA® Quadro® (デュアルグラフィックカード対応)
備考	DVDスーパーマルチドライブ / DVD-ROMドライブ

※2CPU搭載可能モデルにおいては、1CPU搭載時は使用可能なメモリスロットが制限され、最大メモリー容量は各表記の半分の容量となります。



先進のレノボテクノロジーとクオリティ

先進の技術を使いやすく。レノボでは、製品のライフサイクルを通じて、高いパフォーマンスと安定した稼働を基本に、常にユーザー視点に立って細かな所まで配慮した製品設計・開発を行っています。ユーザーの作業環境に最適な構成と、より快適な業務遂行に貢献する。それがレノボの求める高性能です。

QUALITY

筐体内の各パーツを効率的にクールダウンする「トリプル・チャンネル・エアフロー」

筐体内の熱を効率よく外部に放出するために、ThinkStation C30では冷却効果の高い「トリプル・チャンネル・エアフロー」を採用しています。高温の原因となるハードディスク、グラフィックカード、CPUのそれぞれに風の通り道ができるよう設計。風がまっすぐ抜けるよう3つのファンを設置し、筐体内を効率的に冷却します。また、3つのエアフローを設けることで、システムコンポーネントの長寿命化にもつながります。



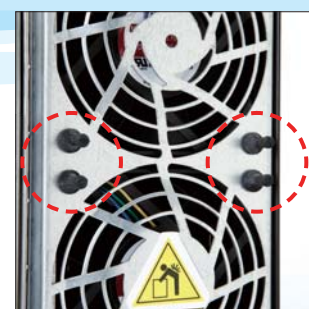
ハードディスク、グラフィックカード、CPUを効率よく冷却するトリプル・チャンネル・エアフロー
※写真は実物と異なる場合がございます。

最適なクーリング設計により-5~8℃を実現し、パフォーマンスを向上

ThinkStationは、それぞれの筐体に最適なクーリング設計を追求することで、シリーズを通して熱に弱いHDDの温度を他社同等クラスと比較し約5~8℃低く保ち故障を低減。安定稼働をサポートしてお客様の貴重なデータを保護します。

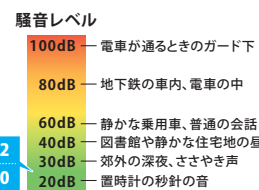
人のささやきよりも静か。冷却効果と静音性を両立

冷却効果に優れた「オウルブレード」は、静音性にも優れています。ファンの回転数を抑えることができ、約24dB(待機時)*と人のささやきよりも静かです。またこの他にも、ファンの表面に特殊な加工を施したり、金属ネジの代わりに防振ゴムを採用するなど、静音性に配慮した設計をいくつも取り入れています。 ※E32/C30



防振ゴムを採用し、ファンの振動を抑制

人のささやきよりも静か

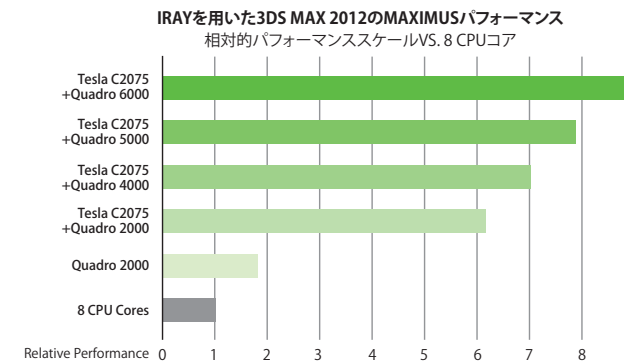


※写真は実物と異なる場合がございます。

PERFORMANCE

GPUコンピューティングに対応

ThinkStationシリーズは、定番であるNVIDIA®のすべての高性能グラフィックカードをサポート。最高でQuadro® 6000やTeslaをサポート。演算処理では最大8倍。3Dアプリケーションでは最大5倍と大幅な高速化が可能です。さらに、流体シミュレーションやデータ解析など高い負荷の掛かる業務をスムーズに行える最新のNVIDIA® Maximus™ テクノロジー構成にも対応*。3Dレンダリングや膨大なデータ処理など、強力なコンピューターパワーが必要とされる業務もスムーズに行うことができます。*(S30、C30、D30)

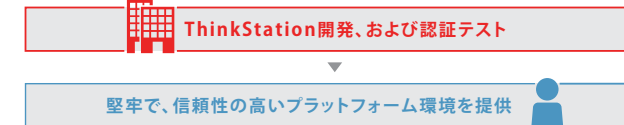


緊密な関係が築いた高い信頼性

レノボでは、主要な独立ソフトウェアベンダーと強力なパートナーシップを構築し、安定して稼働する最適なプラットフォームを保証。OSやグラフィックベンダーに加え、独立系ソフトウェアベンダー各社が行う厳密な認証テストをクリアし、各社からISV認証を取得しています。ThinkStationシリーズも、開発段階からテストを繰り返して安定稼働を検証。ユーザーが常に安心してシステムを利用できる体制を整えています。

※認定アプリケーションベンダー情報の詳細はお問い合わせ下さい。

OSベンダー	グラフィックスベンダー	認定アプリケーションベンダー
Microsoft® Red Hat®	NVIDIA®	Autodesk Dassault Systèmes SolidWorks PTC Siemens
		Adobe ANSYS MSC Avid Schlumberger



環境に合わせたOS選択が可能

ThinkStationシリーズは、ユーザー環境に合わせたオペレーションシステムを利用していただくことが可能です。出荷時に搭載されるWindows® 7 Professional、Windows 8 Pro以外にも、Windows® XP ProfessionalやWindows® 7 Ultimate、Red Hat® 6.2をサポートします。

ECOLOGY

最高レベルのグリーン性能

ENERGY STARへの適合*を目指した製品開発はもちろんのこと、地球環境保全のため、レノボは再生プラスチックの採用を積極的に推進しています。また、全機種が電子製品の環境に与える影響の総合評価基準「EPEAT」の最高基準であるGOLDに格付けされています。さらに、屋内の空気品質維持の環境基準「GREENGUARD」をワークステーションで唯一取得しています。さまざまな方面から最高レベルのグリーン性能を認められたワークステーションです。

※厳密には各製品の構成に依存します。

消費電力を大幅に削減

ThinkStationは、消費電力の削減にも貢献します。電源効率の指標となる80PLUS認証については、全機種においてGOLDもしくはBRONZE認証取得の電源ユニットを採用しています。



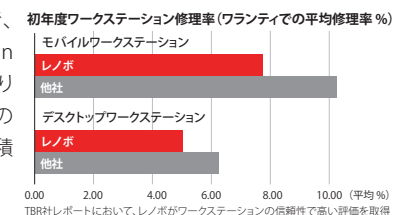
プロフェッショナルを満足させる品質の追求

ワークステーション専任チームによる開発

米ノースカロライナ州ラーレイのThinkStation専任チームでは、経験豊富な技術者が高度な解析・シミュレーションツールを駆使し、様々な物理テストを繰り返しながら、ワークステーションの開発に日々取り組んでいます。グラフィックス/ソフトウェア・ベンダーとの共同検証の成果や、ユーザーからのフィードバック情報などもここに集約。いかに高いアプリケーション性能を発揮しながら熱を制御し安定稼働させるか。いかに筐体の堅牢性と省スペース性、メンテナンス性をバランスよく実現するか。イノベーションへの挑戦は続きます。

継続的な品質改善による着実な成果

レノボでは、全社を挙げて継続的な品質改善に取り組んでいます。その成果として、3年前との比較でThinkStationの初期故障率を半分にまで削減。達成したスコアは業界平均を大きく上回り、ThinkStationの高品質の一端を証明するものとなりました。また、シックスシグマに代表される品質改善への取り組みは、厳格な部品・完成品テスト工程の確立や生産プロセス全体のスピード化にも寄与。多くのPCメーカーがEMS (Electronics Manufacturing Service) に生産を委託する中で、レノボはThinkStationの自社生産にこだわり、自社内での生産技術の向上・ノウハウの蓄積に取り組んでいます。



細やかな配慮でユーザビリティを向上

日々、業務に利用するワークステーションだからこそ、細かな部分まで使い勝手を考慮し、ユーザビリティを追求し設計・開発しています。ユーザーの使いやすさを求めて、できあがった形。それがレノボ ThinkStationのクオリティです。

USABILITY

余裕のあるUSBポート配置

外部機器の接続に使われることの多いUSBポート。ThinkStationシリーズでは、USBポート間の間隔を広げ、ケーブルの抜き差しをしやすい配置に設定。周囲の接続ケーブルに影響を与えない設計です。



高剛性で排熱効率に優れた筐体デザイン

コンピュータシステムは、安定稼働のために、内部で派生した熱を効率的に排出する必要があります。ThinkStationシリーズは、高性能システムを安定的に運用するため、内部の熱を効率的に排出するとともに、振動や外部からの衝撃に強い高剛性の筐体設計を実施。また、便利で持ちやすいエルゴノミックハンドルを全機種に装備。移動や設置時の落下トラブルを防止しています。



ツールレスで内部アクセスが可能

ドライバーなどを使用せずに内部、機器へのアクセスを容易にするツールレス筐体を採用。内部の配線のシンプル化を行い、HDDやグラフィックカードに簡単にアクセスすることが可能です。メンテナンスや部品交換に便利な構造です。

1-2-3ステップで簡単メンテナンス (ThinkStation C30の場合)



ステップ1 工具を使わずに開閉できる筐体
ステップ2 直感的に作業できるシンプルな設計
ステップ3 素早くパーツを交換

※写真は実物と異なる場合がございます。

29in1カードリーダー搭載

ワークステーションで扱う大容量データの持ち運びに便利な、メモリーカードリーダーを搭載。25種類のメディアに対応し、スムーズな書き込みと読み出しに対応しています。

信頼性の高いSASに対応

ThinkStationでは、データアクセスが非常に高速で信頼性の高いSASストレージに対応する、SASコントローラーをご用意しています。お使いの機種に応じて、カードあるいはROMIによるご提供で、SAS規格のHDDやSSDをご利用いただけます。

DATA PROTECTION

簡単操作でデータ復活 Rescue and Recovery

突然のトラブルで、大切なデータをすべて失ってしまった。そんな時、簡単操作ですぐにデータや設定をバックアップを作成した際の状態に復元します。

ThinkVantage Rescue and Recoveryは、事前にセットアップすることにより、リカバリーメニューから選択するだけであらかじめバックアップされているデータを復活させることができます。ただし、トラブルの状況によっては、データが復元できない場合もございます。ワークステーション内の領域に拡張領域が存在する場合、インストールを行うことができません。複数パーティションを作成する場合には、すべて基本区画で作成する必要があります。

SECURITY

BIOSレベルで提供される2種の起動パスワード

Windowsなどオペレーティング・システム・レベルで提供されるパスワードの他に、BIOSによって提供される「パワーオン・パスワード」と「ハードディスク・パスワード」が利用できます。パワーオン・パスワードはパスワード無しでの起動を防止し、情報漏えいや改ざんを防ぎます。

【ご注意】ThinkVantageはガイドに基づいた設定を行うことにより、利便性やセキュリティなどが向上します。Think製品の購入やThinkVantageソフトウェアをインストールしただけでは利便性やセキュリティなどが向上しません。ガイドに基づいた設定を確実に実行することをおすすめいたします。ご使用いただく機種やオペレーティング・システムにより、ご利用いただける機能が制限される場合がございます。また、機能によっては、レノボホームページのサポート・コーナーから該当ソフトウェアをダウンロードしていただく必要がある場合がございます。

場所を問わずにワークステーションのパワーを必要とするユーザーに最適なモバイルモデル。CPUには、インテル® Core™ i7 プロセッサを採用しています。専用グラフィックチップも搭載するほか、高性能グラフィックカードにも対応し、外出先でもシミュレーションや3D CADなどのノートPCでは処理できない高度なグラフィック処理や演算能力を利用可能です。また、ThinkStationと同様に主要ISVでの認証を取得しています。



THINKPAD W530

モバイルワークステーション

第3世代インテル® Core™ i7 プロセッサ搭載。モバイル対応のワークステーション

CAD	BIM	デジタル コンテンツ 制作	CAE
-----	-----	---------------------	-----

用途に応じて選べるThinkStationシリーズ

THINKSTATION E32/E32 SFF

エントリー・ワークステーション

インテル® Xeon® プロセッサ E3-1200ファミリー搭載。優れた初期導入コストの最新機能モデル

2D CAD	エントリー 3D CAD	BIM	WEB制作 DTP	医療
--------	-----------------	-----	--------------	----

PC並みの導入コストで得られるエントリーモデル。十分な拡張性と最新技術を導入したCPUとチップセットを採用し、高度な業務もスムーズに処理することが可能です。高精細の描画や大量のデータ処理も効率的に処理。電子カルテや画像診断を利用する医療現場や建設設計業務、デジタルコンテンツの制作をさらに快適にするモデルです。



THINKSTATION S30

スタンダード・ワークステーション

インテル® Xeon® プロセッサ E5-2600/1600ファミリー搭載。優れた拡張性で最適な構成が可能

3D CAD	2D CAD	デジタル コンテンツ 制作	CAE	CAM
--------	--------	---------------------	-----	-----

優れた拡張性を持ち、業務に応じて自由にカスタマイズが可能なモデル。研究開発業務や建築設計、各種3Dコンテンツの制作など、幅広い分野の業務に対応するスタンダードモデルです。高性能グラフィックカードやGPUコンピューティングにも対応し、スムーズでストレスのない作業環境が得られます。



THINKSTATION C30

コンパクトハイエンド・ワークステーション

インテル® Xeon® プロセッサ E5-2600ファミリー搭載。世界最小サイズに高性能を凝縮

グラフィック デザイン	3D CAD	BIM	デジタル コンテンツ 制作	金融 トレー ディング
----------------	--------	-----	---------------------	-------------------

わずか24ℓのコンパクトサイズに、最大16コア・デュアルCPUとデュアルグラフィックカードに対応した高性能を搭載。最大16画面出力も可能で、ラック収納にも対応。高い描画性能と演算能力を持ち、高速シミュレーションを必要とする金融トレーディングや3D CADを駆使する建築設計などに最適です。



THINKSTATION D30

ハイエンド・ワークステーション

インテル® Xeon® プロセッサ E5-2600ファミリー搭載。余裕の高性能で高負荷業務もスムーズ

グラフィック デザイン	解析・ シミュレ ーション	3D CAD	CAE	EDA
----------------	---------------------	--------	-----	-----

最大16コアのプロセッサを選択可能で、解析作業や動体シミュレーションなどの高負荷業務に最適。高い機能拡張性を備え、サーバークラスの処理能力を発揮します。連続する3Dレンダリングなど大量のデータの演算・描画能力を必要とするCAEや3Dアニメーション制作などの業務に余裕のパワーで応えます。



ThinkStationシリーズをさらに詳しく知りたい方はこちら



ThinkStationポータルサイトのご紹介

ThinkStationポータルサイトでは、製品のご紹介をはじめ、お得なキャンペーン情報、主要ISVとのソリューション紹介、そして実際に製品を導入いただいたユーザー様の事例紹介など、ユーザーの皆様へ有益な情報を随時更新しています。

<http://www.lenovo.jp.com/thinkstation/>

THINKVISION LT3053p Wide

30型、WQXGA解像度で作業の効率化に貢献。プロフェッショナル向けフラッグシップモニター。

CAD	BIM	デジタル コンテンツ 制作
-----	-----	---------------------

大画面30インチ、WQXGA(2560×1600ドット) 解像度を採用したプロ仕様のモニター。表示範囲が広いので、情報量が増え、画面の拡大や縮小、スクロールの手間が減少します。表示色数は約10億7000万色、Adobe RGBカバー率99%、sRGBカバー率100%の高い色再現性を実現。色の正確な再現性が求められる作業にも最適です。

